



東特塗料株式会社

金属基板用 高耐熱、高熱伝導率接着シートの開発

研究課題

パワーエレクトロニクスデバイスの放熱

開発目標

ガラス転移温度 : 200°C 以上

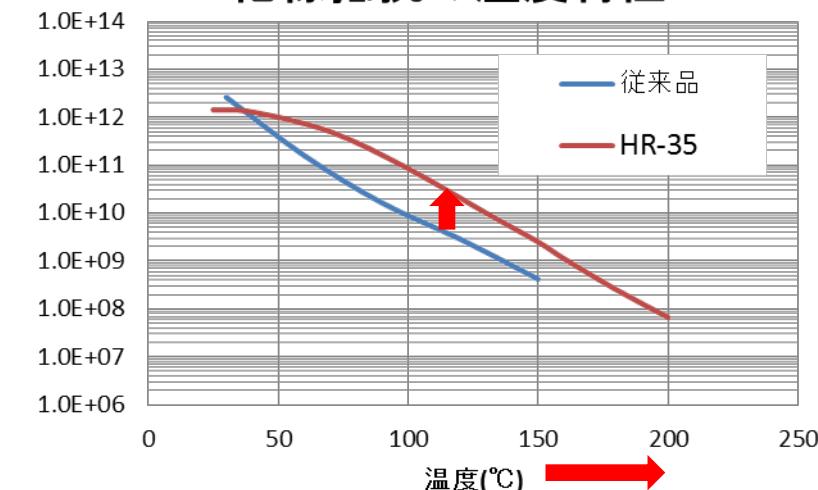
熱伝導率 : 6W/m·K 以上

柔軟性 : 金属基板の曲げ加工性

開発品

	単位	HR-35
銅箔厚さ	μm	70
絶縁層厚さ	μm	100
絶縁層外観		良好
破壊電圧	kV/mm	59
半田耐熱性(300°C)	分	>10
ピール強度	kN/m	2.2
絶縁抵抗(25°C)	Ω	1.1E+12
絶縁抵抗(160°C)	Ω	1.2E+9
ガラス転移温度(粘弾性)	°C	245
熱伝導率(周期加熱放射測温法)	W/m·K	6.4

絶縁抵抗の温度特性



従来品



開発品
HR-35

良好な基板曲げ加工性

ご協力:(株)日本理化工業所様

東特塗料株式会社

367-0046 埼玉県本庄市栄3丁目9番33号

0495-22-4211 (代)

<http://www.totoku-toryo.co.jp/>